

2007-2008年芯片设计行业 发展预测与投资分析

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2007-2008年芯片设计行业发展预测与投资分析》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/G2532713EP.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2007-2008年芯片设计行业发展预测与投资分析 内容介绍：

2000年国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》发展IC设计的政策方针，以及产业各方对IC设计业龙头地位的认识程度的不断加深。同时，集成电路制造水平的不断提升也为IC设计业的迅速发展提供了坚实的基础。

虽然全国已有200多家IC设计公司，但他们的产值还没有一家中型台湾设计公司的一半。从任何角度都只能得到一个结论，中国的芯片设计业还没有真正起步，更没有成功的经验。目前中国的IC设计公司都普遍存在下面四个方面的问题：1.没有一个良好的股权/资金结构，企业没有危机感，员工没有归属感；2.公司结构不合理，商务活动不是董事会唯一的考虑，对人才和市场的投入力度不够；3.没有自己的核心技术和产品；4.没有长远的企业目标，不能专注。如果中国的IC设计公司想满足客户的要求，就必须要有独特的桥梁把自己与整机厂联系起来。也就是说，中国IC设计公司必须对系统，特别是下一代产品系统有深入的了解，以弥补整机厂的技术能力缺陷，为他们提供超越芯片的整体解决方案。这个模式与美国仅限于为客户提供芯片的做法有很大的差别。

展望未来，如果foundry与设计业同步发展，大约10年后，世界的IC产业区分为五大块，即美国、欧洲、日本、韩国及中国（内地与台湾）。其中中国所占的比重将逐渐增加，到2012年左右将达到25%（其中内地约占10%，主要占领中低档市场；台湾占15%，在中高档产品上与美国抗衡）。20年后，中国将升至第一大IC产业区，大约占世界的三分之一份额，其中长江三角洲和珠江三角洲这两个地区将成为中国IC设计业的重镇，那时无论是规模还是技术水准都将占据世界领先地位。

本报告数据来源于信产部、统计局、国研网、万方数据库、国研网数据库、电子材料协会、晶圆代工半导体厂商协会，以及新浪、搜狐等门户网站，各公司网站，还有著名国际咨询机构如IDC、Garter、iSuppli等著名分析师的定性预测。报告中对于产业的发展现状、供求情况、市场结构进行了审慎的剖析，并对产业发展前景及市场情况进行了定量预测。产业链各方、政府机构、投资实体把握产业发展脉络，制定理性决策有一定的借鉴意义。

第一章 行业发展综述

第一节 行业界定

一、行业经济特性

二、细分市场概述

三、产业链结构分析

第二节 芯片设计行业发展成熟度分析

- 一、芯片设计行业发展周期分析
- 二、中外芯片设计市场成熟度对比
- 三、细分行业成熟度分析

第二章 2006年全球芯片设计业发展概述

第一节 发展现状

- 一、产业规模
- 二、产业结构

第二节 基本特点

- 一、市场繁荣带动产业加速发展
- 二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节 主要国家和地区发展概要

- 一、美国
- 二、日本
- 三、中国台湾地区

第三章 中国芯片设计行业的竞争状况

- 二、我国芯片设计业的国际竞争力
- 三、外资企业大举进入国内市场的影响

第二节 我国芯片设计业的竞争现状

- 一、我国芯片设计企业间竞争状况
- 二、潜在进入者的竞争威胁
- 三、供应商与客户议价能力

第六章 产业发展地区比较

第一节 长三角地区（以上海、江浙为代表）

- 一、行业发展现状
- 二、竞争优势
- 三、发展前景

第二节 珠三角地区（以广州、深圳、珠海为代表）

- 一、行业发展现状
- 二、竞争优势
- 三、发展前景

第三节 环渤海地区（以北京、天津为代表）

一、行业发展现状

二、竞争优势

三、发展前景

第四节 东北地区（以沈阳、大连为代表）

一、行业发展现状

二、竞争优势

三、发展前景

第五节 西部地区（以成都、西安为代表）

一、行业发展现状

二、竞争优势

三、发展前景

第七章 芯片设计产品细分(芯片设计产品细分市场分析)市场分析

第一节 电子芯片市场

一、电源管理芯片市场

（一）全球市场概况

（二）我国市场规模

（三）我国市场结构与特点

（四）市场发展预测

（五）主要竞争厂商

二、LED外延芯片市场

（一）主要竞争厂商

（二）产品技术规划及发展趋势

（三）芯片性能与价格

（四）市场规模预测

第二节 通讯芯片市场

一、全球市场概况

二、主要竞争厂商

第三节 汽车芯片市场

一、全球市场概况

二、我国市场规模

三、主要竞争厂商

第四节 手机芯片市场

- 一、全球市场规模
- 二、我国市场规模
- 三、我国市场结构与特点
- 四、市场发展预测
- 五、主要竞争厂商

第五节 电视芯片市场

一、DLP(数码光处理)芯片

- (一) 技术
- (二) 掌握核心芯片技术的厂商
- (三) 应用该技术的彩电厂商

二、LCOS芯片

- (一) LCOS微显示器
- (二) LCOS面板技术
- (三) 主要优点
- (四) 掌握核心芯片技术厂商
- (五) 应用该技术的彩电厂商

三、数据机顶盒芯片

- (一) 主要竞争厂商
- (二) 国内机顶盒生产商及其芯片解决方案
- (三) 产品技术规划及发展趋势
- (四) 芯片性能与价格
- (五) 市场规模预测

第八章 2007-2008年行业发展前景展望与预测

第一节 发展环境展望

- 一、宏观经济形势展望
- 二、政策走势及其影响
- 三、国际行业走势展望

第二节 相关行业发展展望

- 一、IC制造业展望
- 二、IC封装测试业展望
- 三、IC材料和设备行业展望

第三节 行业发展趋势展望

一、技术发展趋势展望

(一) 产品设计由ASIC向SOC转变

(二) 设计方法由反向向正向转变

二、产品发展趋势展望

三、行业竞争格局展望

第四节 芯片设计市场发展预测

一、2007-2008年中国芯片设计(芯片设计市场分析)市场规模预测

二、细分市场规模预测

三、产业结构预测

四、销售模式：由提供芯片向提供整体解决方案转变

第九章 行业内优势企业分析

第一节 上海华虹(集团)有限公司

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

第二节 中星微电子

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

第三节 中芯国际

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

第四节 大唐微电子

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

第五节 其他优势企业

一、杭州士兰微电子股份有限公司

二、有研硅谷

三、上海蓝光

四、扬州华夏

五、深圳方大

六、大连路美

七、台湾信越

八、台湾威盛电子

第六节 国外优势企业分析

一、意法半导体

二、飞利浦

三、德州仪器

四、英特尔

五、AMD

六、LG电子

七、国家半导体

八、FREESCALE

第十章 行业投资机会与风险分析

第一节 行业投资环境评价

一、行业投资状况

二、在建及拟建项目分析

三、投资吸引力分析

第二节 行业投资机会分析

第三节 行业投资风险分析

一、市场风险

二、政策风险

三、经营风险

第四节 行业投资建议及策略

图表目录

图表 1：2006年全球半导体电子设备设计国家排名

图表 2：2006年全球IC设计产业布局

图表 3：全球IC设计产业概况

图表 4：2006年台湾地区前十大设计公司

图表 5：台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势

图表 6：2001-2006年间国内生产总值增长趋势

图表 7：2005Q1-2007Q2年各季度国内生产总值走势

图表 8 : 2002-2006年工业增加值及其增长速度

图表 9 : 1994-2006年工业增加值发展速度预警

图表 10 : 2004Q4-2006Q4工业企业景气波动趋势

图表 11 : 2001-2006年工业企业利润增长情况

图表 12 : 2006年工业增长速度再次超过其他部门

图表 13 : 2005、2006年不同行业规模以上工业企业利润总额对比 (千元)

图表 14 : 2002-2007上半年固定资产投资增长情况

图表 15 : 2001-2006年中国投资率和消费率变化情况

图表 16 : 我国有线电视向数字化过渡时间表

图表 17 : 低功率芯片技术实现

图表 18 : 微笑曲线

图表 19 : 2006年中国前十大IC设计业者排名

图表 20 : 2002-2006年IC设计业销售收入

图表 21 : 2005-2006我国芯片设计业经济指标

图表 22 : 我国IC设计业的SWOT分析

图表 23 : 西部地区一些IC设计公司

图表 24 : 2005年中国电源管理芯片(电源管理芯片市场分析)市场品牌结构

图表 25 : DLP工作原理

图表 26 : 使用DLP技术的厂商一览

图表 27 : LCOS面板结构图

图表 28 : 宏观经济先行指数

图表 29 : 宏观经济预警指数

图表 30 : 中国集成电路产业规模和增长速度

图表 31 : 2007-2011年我国IC销售额预测

图表 32 : 中国IC(IC市场分析)市场应用结构及自给能力

图表 33 : 中芯国际技术文件的支持包括:

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/G2532713EP.html>